

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票募集资金项目的

可行性分析报告（修订稿）

为提升公司核心竞争力、增强公司盈利能力，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“联得装备”或“公司”）拟非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）募集资金。公司董事会对本次非公开发行募集资金运用的可行性分析如下：

一、本次募集资金投资计划

本次发行拟募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元。募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目：

单位：万元

序号	项目名称	本次募集资金拟投入额
1	汽车电子显示智能装备建设项目	24,000
2	大尺寸 TV 模组智能装备建设项目	16,000
3	半导体封测智能装备建设项目	16,000
4	补充流动资金项目	24,000
合计		80,000

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分由公司自筹资金解决。

二、募集资金投资项目的必要性和可行性

（一）募集资金投资项目的必要性

1、我国电子装备制造业发展的需要

平板显示器件及相关零组件生产设备制造业是一类重要的电子工业专用设备制造业，也是装备制造业的重要分支，是影响一个国家或地区电子信息产品制

造业和平板显示行业发展水平的重要基础，我国制定了一系列的法律法规和产业规范来促进我国平板显示器件及相关零组件生产设备制造行业的发展。随着“中国制造 2025”时代的来临，大力推动重点领域突破发展，聚焦包括新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人在内的十大重点领域成为了我国实施制造强国战略的重点任务。

尽管自 20 世纪以来，我国电子专用设备产业已经取得了较大的发展成绩，但仍存在一些突出的问题，比如：产业规模偏小、本土企业整体实力不强；自主创新能力有待提高、高端设备开发相对落后；部分产品性价比虽高但市场占有率低；高水平、复合型人才缺乏等。整体而言，我国电子专用设备的发展水平与发达国家相比仍存在一定差距，许多重大关键设备仍需依赖进口。

公司将通过本项目的实施，进一步扩大国内电子专用设备企业在全球市场占有率的提升，进一步扩大我国电子专用设备产业规模并提升技术水平。作为我国领先的电子专用设备制造商，公司将以本项目为契机，逐步提升本土企业在国际市场上的声誉。因此本项目的实施有利于推动我国电子专用设备制造业的发展，符合“中国制造 2025”时代的发展需求。

2、优化产品结构和业务布局，拓展新的利润增长点

公司产品主要为平板显示器件及相关零组件生产设备，主要下游客户为国内外平板显示领域的知名企业，该类客户产品主要应用于智能手机、平板电脑、平板电视、液晶显示器等新兴消费类电子产品。同时公司积极创造并把握大尺寸设备研发的先发优势。本次非公开发行，将进一步丰富和拓展公司产品线、优化产品结构，通过本次募集资金投资项目的实施，公司将进一步切入汽车电子显示、大尺寸平板电视及半导体封测行业领域，为公司经营业绩增长提供新的动力，同时降低单个领域市场变动对公司整体业绩的影响，提高公司抗风险能力及综合竞争实力。

3、补充流动资金

公司拟将本次非公开发行股票中的 24,000.00 万元用于补充流动资金。公司加快新产品开发落地、维护日常经营均需要持续的资金投入。通过非公开发行股

票募集资金，公司可以进一步充实资金实力、优化资本结构、进一步提升盈利水平。

(1) 满足公司经营发展中对资金的需求

近年来，公司主营业务规模持续扩大、营业收入增长持续增长，对公司营运资金提出了更高的要求，对流动资金的需求较大。同时，公司不断加大研发资金投入、提升自主创新能力，并积极引进优秀的管理、技术人才。本次补充流动资金将为公司未来日常经营发展、研究开发等提供有力的资金保障。

(2) 优化资本结构，提升盈利能力

公司使用部分募集资金用于补充流动资金，将缓解公司营运资金压力，改善资产结构，进一步降低经营风险和财务风险，有助于公司提高竞争力、抓住市场机遇、提高经营业绩。

(二) 募集资金投资项目的可行性

1、下游行业发展迅速，为相关智能装备制造企业带来机遇

公司本次非公开发行股票募集资金并在东莞地区建设生产基地，在发行人现有产品的基础上进一步新增汽车电子显示、大尺寸智能电视、半导体封测等应用领域，进一步优化公司的产品结构、增加新的利润增长点并进一步增强公司的盈利能力。

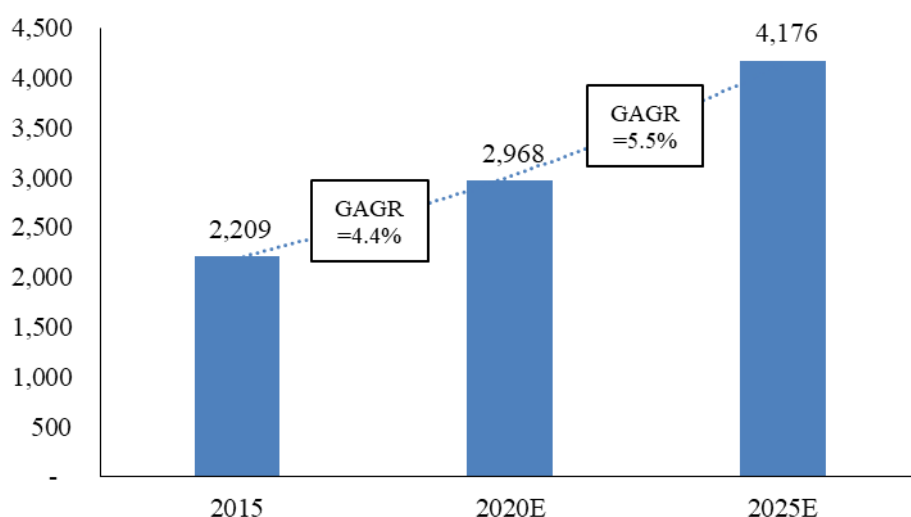
上述应用领域具有良好的发展前景和广阔的市场空间，具体情况如下：

(1) 汽车电子显示领域

在智能化、网联化及电子化的浪潮下，汽车已经从传统的机械产品发展为电子信息系统控制的智能产品。随着用户对汽车尾气排放、安全性、舒适性、娱乐性的需求不断提高，以及自动驾驶系统、信息娱乐与网联系统部件的不断应用，汽车电子化已成为未来汽车工业发展的一大趋势。

2015 年，全球汽车电子市场规模为 2,209 亿美元。2020 年，该市场规模预计达到 2,968 亿美元，并以 5.5% 的年均复合增长率在 2025 年预计增长至 4,176 亿美元。

2015 年至 2025 年全球汽车电子市场规模（亿美元）

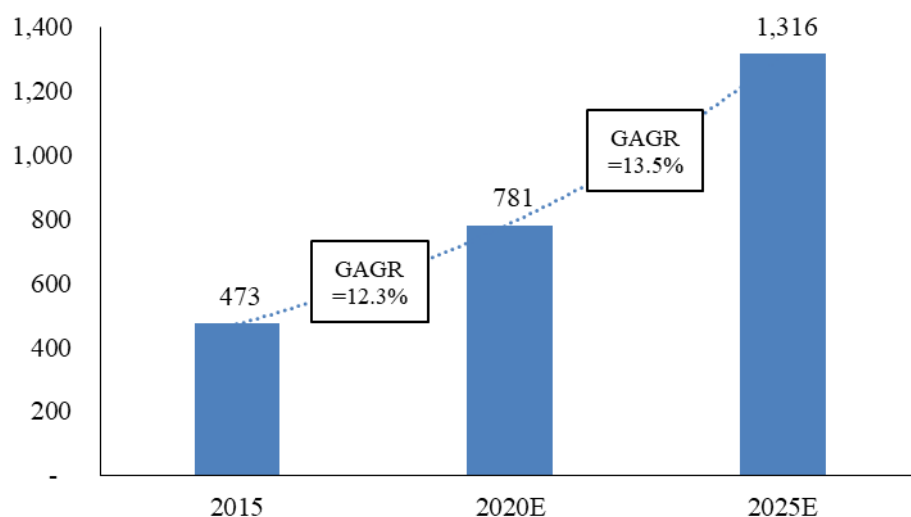


数据来源：HIS、Strategy Analytics、中金公司研究报告

根据国务院发展研究中心发布的《中国汽车产业发展报告》，目前中国新车汽车电子产品成本在整车成本中的平均比重为 10%，轿车电子产品成本比重已达 10%~25%，世界平均每辆汽车中的电子产品成本占比达 35%，未来国内汽车电子成本占总整车成本比例将有所提升，为汽车电子产业带来巨大的增量空间。

2015 年，国内汽车电子市场规模为 473 亿美元。2020 年，该市场规模预计达到 781 亿美元，并以 13.5% 的年均复合增长率在 2025 年预计增长至 1,316 亿美元。

2015 年至 2025 年国内汽车电子市场规模（亿美元）

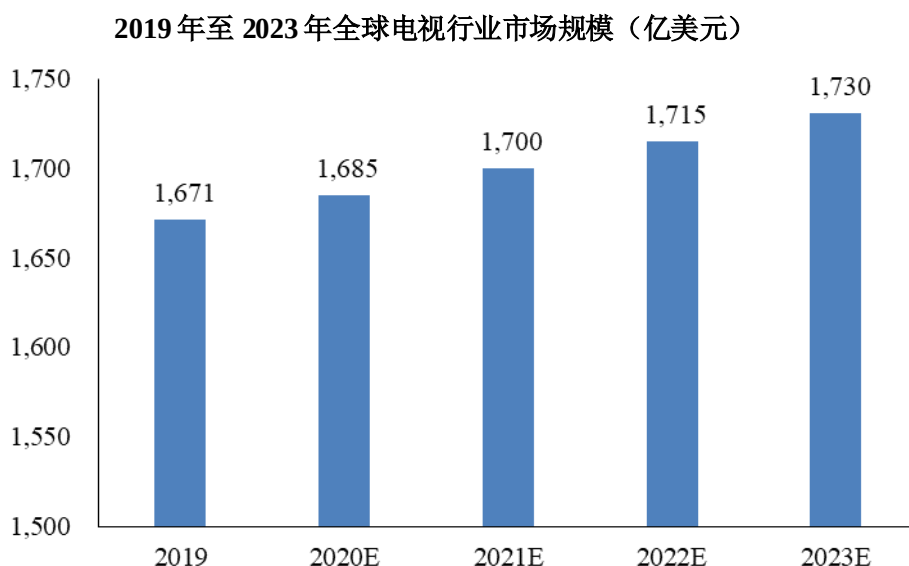


数据来源：HIS、Strategy Analytics、中金公司研究报告

（2）大尺寸平板显示领域

随着移动互联网、物联网、云计算、大数据等技术的不断成熟及迅猛发展，智能电视逐渐成为家庭重要的视听、娱乐和信息分享交互智能终端，市场需求持续增长，销售量不断攀升。根据 Strategy Analytics 数据，2018 年智能电视全球销量达到 1.57 亿台，占全年电视总销量的 67%。

根据 Statistia 数据，2019 年包括智能电视在内的全球电视行业市场规模为 1,671 亿美元，该市场规模预计在 2020 年达到 1,685 亿美元。

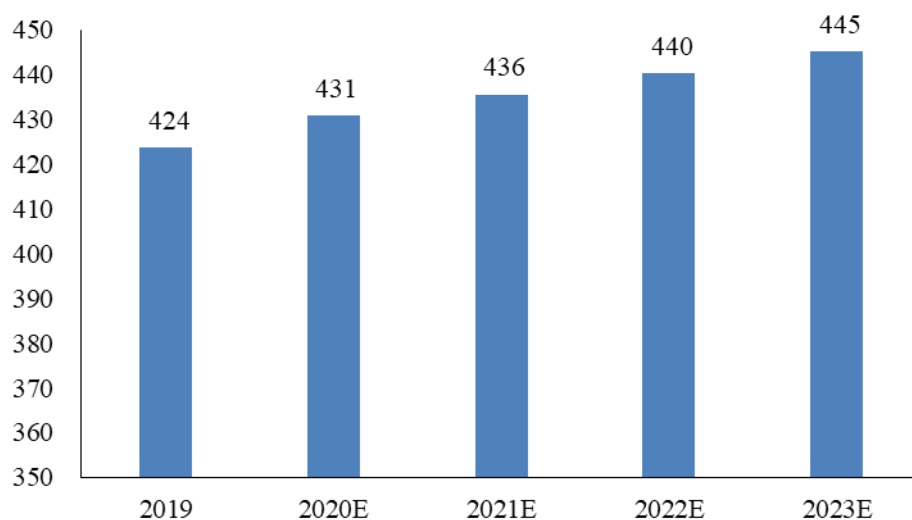


数据来源：Statistia

与此同时，我国智能电视行业也在快速发展，主要传统电视厂商及华为、小米、OPPO、PPTV 等互联网企业均推出了智能电视品牌及产品。根据前瞻产业研究院数据，2014 年-2018 年，我国智能电视市场销量由 2,931 万台增长至 4,249 万台，复合增长率 9.37%，呈快速增长态势。

根据 Statistia 数据，2019 年包括智能电视在内的国内电视行业市场规模为 424 亿美元，该市场规模预计在 2020 年预计达到 431 亿美元。

2019 年至 2023 年国内电视行业市场规模（亿美元）



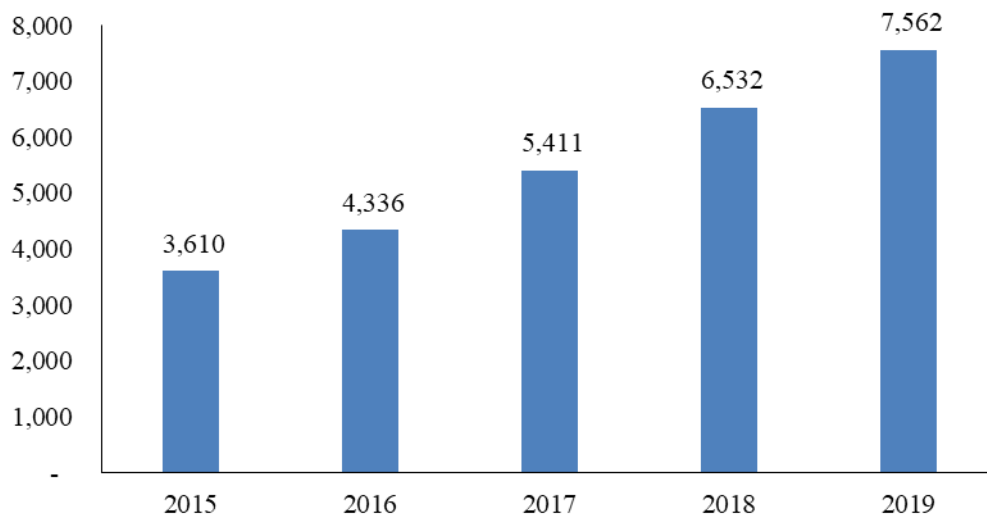
数据来源: Statista

(3) 半导体封测领域

半导体行业是电子信息产业的基础,半导体和其他元器件通过集成电路板连接,应用于个人电脑、智能手机、汽车电子等终端产品、承担信息的载体和传输功能,是信息化社会的重要基石之一。

根据世界半导体贸易统计组织 WSTS 统计,2019 年全球半导体产业市场规模为 4,121 亿美元,预计在 2020 年将增长至 4,330 亿美元,行业景气度良好,市场空间巨大。我国是全球半导体市场规模增速最快的国家之一。根据中国半导体行业协会统计,2018 年和 2019 年,我国半导体产业市场规模分别为 6,532 亿元和 7,562 亿元,同比增长率分别为 20.7%和 15.8%,显著高于全球半导体产业市场增速。

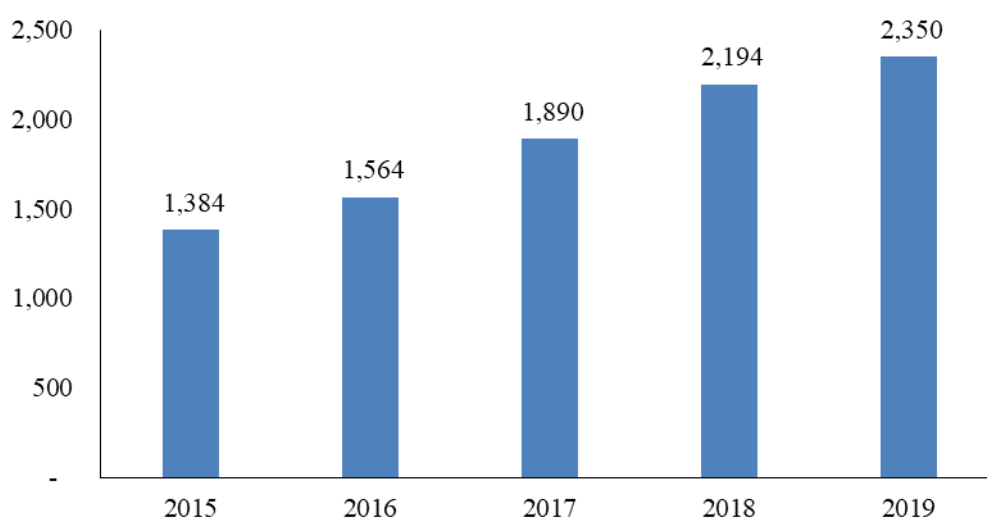
2015 年至 2019 年国内半导体产业市场规模 (亿元)



数据来源：中国半导体行业协会

半导体产业主要包括芯片设计、芯片制造和封装测试三个部分。其中封装主要为保护芯片免受物理、化学等环境因素的伤害，增强芯片散热性能，实现电气连接并确保电路正常工作；测试主要为对芯片的功能、性能进行测试。我国半导体封测产业保持快速增长，根据中国半导体行业协会统计，2019 年我国半导体封测产业规模为 2,350 亿元，占整体产业规模的 31%。2015 年至 2019 年，我国半导体封测产业规模复合增长率为 14.15%。

2015 年至 2019 年国内半导体封测产业市场规模（亿元）



数据来源：中国半导体行业协会

同时伴随全球众多晶圆厂项目的投入建设，大批新建晶圆厂产能的释放也将带来更多的半导体封测新增需求，推动半导体封测产业继续增长。

半导体产业作为信息产业的核心和基础，受到国家政策的大力支持，随着《国家集成电路产业发展推进纲要》、《集成电路产业“十三五”发展规划》和《中国制造 2025》等相关政策的稳步推进，半导体产业及封测子产业有望迎来新的发展机遇。

目前全球及国内在汽车电子显示、大尺寸平板显示、半导体封测领域发展前景良好，为本次募投项目新增产品销售及产能消化提供了良好的市场保障。

2、项目建设符合国家相关政策规划的要求

发行人本次募集资金投资项目建设，符合国家相关政策规划的要求，项目建设和实施具有良好的政策基础和环境，具体情况如下：

（1）汽车电子显示领域

目前，汽车已发展为电子信息系统控制的智能产品，作为汽车向高安全性、高环保型发展的重要环节，汽车电子行业已成为汽车工业的重要组成部分和基础。

2017 年以来，国家层面的汽车电子政策密集出台，对汽车电子行业提出了具体的战略部署和行动计划。2017 年，工业和信息化部出台《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020 年）》，其中智能网联汽车规模化应用是行动计划的首要目标之一；2017 年，工业和信息化部、国家发改委、科技部出台《汽车产业中长期发展规划》，指出要突破先进汽车电子等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商；2018 年，工业和信息化部出台《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》，明确以网络通信技术、电子信息技术和汽车制造技术融合发展为主线，充分发挥我国网络通信产业的技术优势、电子信息产业的市场优势和汽车产业的规模优势；2019 年，国家发改委出台《汽车产业投资管理规定》，着力构建智能汽车创新发展体系，聚焦汽车产业发展重点；2020 年，国家发改委等部门出台《智能汽车创新发展战略》，将着力推进车载高精度传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台等产品研发与产业化，建设智能汽车关键零部件产业集群。

（2）平板显示领域

平板显示生产设备制造业是智能装备制造业的重要分支，平板显示生产装备

制造业的发展进步对我国平板显示产业乃至电子信息产品制造业整体水平的发展和提升有着重要的意义。

在 2006 年国务院颁布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》中，就将“新型显示器件生产设备”列入需要重点突破的关键领域。2010 年以来，国家政府又制定了大量的产业政策引导和支持我国平板显示生产设备制造业的发展。比如 2010 年发布的《装备制造业技术进步和技术改造投资方向》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，2011 年发布的《产业结构调整指导目录》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》、《工业转型升级规划（2011-2015 年）》，2012 年发布的《重大技术装备自主创新指导目录》、《电子信息制造业“十二五”发展规划》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》等，2015 年发布的《中国制造 2025》，2016 年发布的《智能制造发展规划（2016-2020 年）》。此外，2011 年修订的《鼓励进口技术和产品目录（2011 年版）》和 2012 年修订的《关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知》还分别将平板显示生产设备及制造技术列入“鼓励引进的先进技术”和“免征进口关税和进口环节增值税”目录中，鼓励我国引进平板显示生产设备相关技术和产品。

（3）半导体行业

半导体行业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，在推动国家经济发展和产业升级上具备战略性作用。

近年来，国家不断出台政策支持半导体产业发展。2012 年，工信部出台了《集成电路产业“十二五”发展规划》，规划的发展目标为到“十二五”末，产业规模再翻一番以上；2014 年，国务院出台《国家集成电路产业发展推进纲要》，指出到 2020 年，集成电路全行业销售收入年均增速超过 20%，并设立国家产业投资基金；2015 年，国务院出台《中国制造 2025》，将集成电路及专用装备作为“新一代信息技术产业”纳入大力推动突破发展的重点领域；2016 年，国务院出台《关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》，将提升封装测试业技术水平和产业集中度，加紧布局后摩尔定律时代芯片相关领域；2019 年，财政部、国家税务总局出台《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》，为符合条件的集成电路企业提供税收优惠。

此外，广东地方政府也出台了相关的产业政策，如《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008—2020 年）》、《广东省智能制造发展规划（2015-2025 年）》、深府〔2014〕96 号《深圳市机器人、可穿戴设备和智能装备产业发展规划（2014—2020 年）》、深府〔2014〕97 号《深圳市人民政府关于印发机器人、可穿戴设备和智能装备产业发展政策的通知》，为智能装备企业提供政策支持。

本项目的建设可以极大地提高企业在智能装备方面的生产能力、推动我国智能装备产业的发展，符合国家相关产业的扶持政策。

3、发行人积累了丰富的客户资源、研发实力、质量和品牌优势及行业经验等，形成核心竞争力，为本次募集资金投资项目的顺利实施奠定了良好的基础

公司自成立以来，专注于平板显示器件及相关零组件生产设备的研发、生产、销售和服务，积累了深厚的技术储备和丰富的市场经验，树立了良好的市场形象和品牌知名度。

在客户资源及业务拓展方面，目前公司已经与富士康、京东方、华为、苹果、深天马、蓝思科技、华星光电、长信科技、立讯精密、维信诺、比亚迪等众多知名客户建立了良好的合作关系，积累了稳定优质的客户资源。同时公司积极拓展与本次募集资金投资项目相关的客户和业务资源。2020 年 1 月公司成为欧洲大陆集团供应商并正式纳入其供应链体系，进一步拓展了公司产品线的应用领域和范围。同时公司积极进行大尺寸模组绑定设备及 TV 模组整线的研发拓展并顺利实现生产销售，加大半导体倒装等设备的研发投入，积极实现更多元化的业务布局。

在研发实力方面，公司为国家级高新技术企业，致力于依靠自主创新实现企业可持续发展。公司设立了邦定事业部、贴合事业部、移动终端事业部、AOI 软体开发部、电子资讯部、视觉开发部、综合事业部、TV 大尺寸部、半导体及光伏事业部等部门，构建了比较完善的研发体制，形成了持续、较强的研发创新能力。在持续加大研发投入、引进优秀技术人才的推动下，公司研发能力处于行业前列。

在品牌与质量方面，随着技术和服务水平的不断提升、品牌影响力的不断深

化、以及市场的不断开拓，公司逐步确立了国内平板显示器件及相关零组件生产设备制造领域的优势地位，并凭借优异的产品质量和多年来积累的核心技术优势在业内树立了良好的口碑。目前，公司已经拥有一批具有长期稳定合作关系的客户，产品已服务于全球领先的知名平板显示产品生产企业并树立了良好的品牌知名度，为公司的持续发展和市场开拓奠定了良好的基础。

在行业经验方面，公司 2002 年就开始就从事平板显示器件及相关零组件生产设备制造，是我国较早进入该领域的企业。十余年来，公司经历了平板显示产业的多种技术变革，对平板显示产业各种知识体系和生产工艺进行了持续的深入钻研和探索，通过多年的技术沉淀和积累实现了平板显示产业各种技术之间的掌握和融合，积累了丰富的平板显示器件及相关零组件生产设备制造经验，具备了良好的产品研发设计能力和制造工艺水平，使公司的产品研发设计能力、产品质量性能均处于行业前列，为公司的可持续发展奠定了良好的基础。

公司凭借突出的研发和创新能力、优质的质量与品牌声誉、丰富的行业经验、深厚的客户资源等，市场地位逐步提升、市场竞争力不断增强。因此，本次募集资金投资项目实施前景明朗。

三、本次募集资金投资项目的的基本情况

（一）汽车电子显示智能装备建设项目

1、项目建设内容

本项目建设期为 2 年，计划投资总额 28,525.37 万元。通过项目建设，公司将建设先进厂房并引进先进生产设备，形成自动曲面 CG 外观及光学设备、车载显示屏电性检查设备、自动曲面屏组装设备、汽车显示总装设备、汽车显示测试设备等智能装备生产能力，进一步优化产品结构并提高公司的综合竞争力和盈利能力。

2、项目实施主体及投资情况

本项目的实施主体为上市公司全资子公司东莞联鹏，项目实施地址为广东省东莞市塘厦镇，公司已取得了募集资金投资项目用地的土地使用权证。

本项目计划使用募集资金不超过 24,000.00 万元用于厂房建设、设备购置等，其余部分由公司自筹解决。本项目建成完全达产后，将实现营业收入 32,000 万元，具有良好的经济效益。

3、项目审批情况

截至目前，该项目的备案及环境影响评价手续已办理完毕。

(二) 大尺寸 TV 模组智能装备建设项目

1、项目建设内容

本项目建设期为 2 年，计划投资总额 18,715.24 万元。通过项目建设，公司将建设先进厂房并引进先进生产设备，形成面板端子清洗设备、OLB 邦定设备、AOI 检测设备、DISP 封胶设备、PWB 绑定设备等智能装备生产能力，进一步优化产品结构并提高公司的综合竞争力和盈利能力。

2、项目实施主体及投资情况

本项目的实施主体为上市公司全资子公司东莞联鹏，项目实施地址为广东省东莞市塘厦镇，公司已取得了募集资金投资项目用地的土地使用权证。

本项目计划使用募集资金不超过 16,000.00 万元用于厂房建设、设备购置等，其余部分由公司自筹解决。本项目建成完全达产后，将实现营业收入 22,850.00 万元，具有良好的经济效益。

3、项目审批情况

截至目前，该项目的备案及环境影响评价手续已办理完毕。

(三) 半导体封测智能装备建设项目

1、项目建设内容

本项目建设期为 2 年，计划投资总额 19,515.52 万元。通过项目建设，公司将建设先进厂房并引进先进生产设备，形成 COF 倒装设备、IGBT 芯片及模组封装设备，进一步优化产品结构并提高公司的综合竞争力和盈利能力。

2、项目实施主体及投资情况

本项目的实施主体为上市公司全资子公司东莞联鹏，项目实施地址为广东省东莞市塘厦镇，公司已取得了募集资金投资项目用地的土地使用权证。

本项目计划使用募集资金不超过 16,000.00 万元用于厂房建设、设备购置等，其余部分由公司自筹解决。本项目建成完全达产后，将实现营业收入 23,000.00 万元，具有良好的经济效益。

3、项目审批情况

截至目前，该项目的备案及环境影响评价手续已办理完毕。

（四）补充流动资金项目

随着公司经营规模的增大，所需的营运资金量也不断增加，适度补充流动资金有助于公司缓解营运资金压力。公司本次非公开发行股票拟使用募集资金不超过 24,000.00 万元用于补充流动资金。本次补充流动资金的规模综合考虑了公司现有资金情况、实际营运资金缺口以及公司未来发展战略，整体规模适当。

四、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响

本次非公开发行股票募集资金不超过 80,000.00 万元，募集资金投资项目的顺利实施将有效地提升公司的生产能力、实现产品结构的升级及多元化，为公司实现发展战略目标奠定良好的基础，增强公司的核心竞争力和盈利能力。

（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行股票募集资金到位后，将为公司的进一步发展提供资金保障。公司资本实力大大增强，本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，项目投产后，公司的营业收入和净利润将进一步提升，盈利能力得到进一步的改善，公司的整体业绩水平将得到稳步提升。

五、本次非公开发行的可行性结论

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司的整体发展战略规划，具有良好的市场前景和经济效益。募集资金投资项目的实施将进一步

扩大公司业务规模，增强公司竞争力，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

综上所述，本次非公开发行募集资金投资项目是必要的、可行的。

（本页无正文，为《深圳市联得自动化装备股份有限公司关于非公开发行 A 股股票募集资金项目的可行性分析报告（修订稿）》签章页）

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日